

Bienvenue chez O-Leading

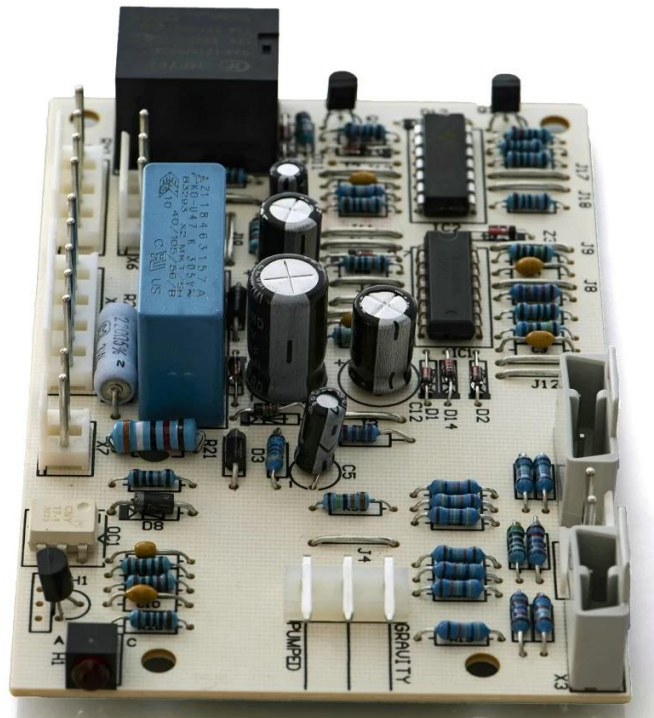
O-Leading s'efforce d'être votre partenaire de solution unique dans la chaîne d'approvisionnement EMS, y compris la conception de PCB, la fabrication de PCB et l'assemblage de PCB (PCBA). Nous fournissons certaines des technologies de PCB les plus avancées, y compris les PCB HDI, les PCB multicouches, les PCB rigides et flexibles. Nous pouvons prendre en charge du prototype à virage rapide à la production moyenne et en masse.

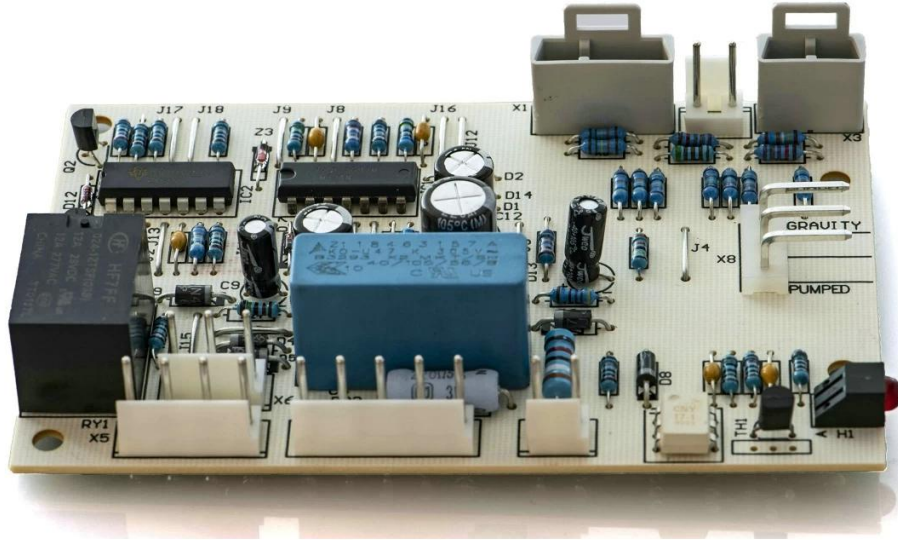
En général, nos clients mondiaux sont très impressionnés par nos services: réponse rapide, prix compétitif et engagement de qualité. Offrir un service technique plus précieux et une solution globale est la voie à suivre pour O.

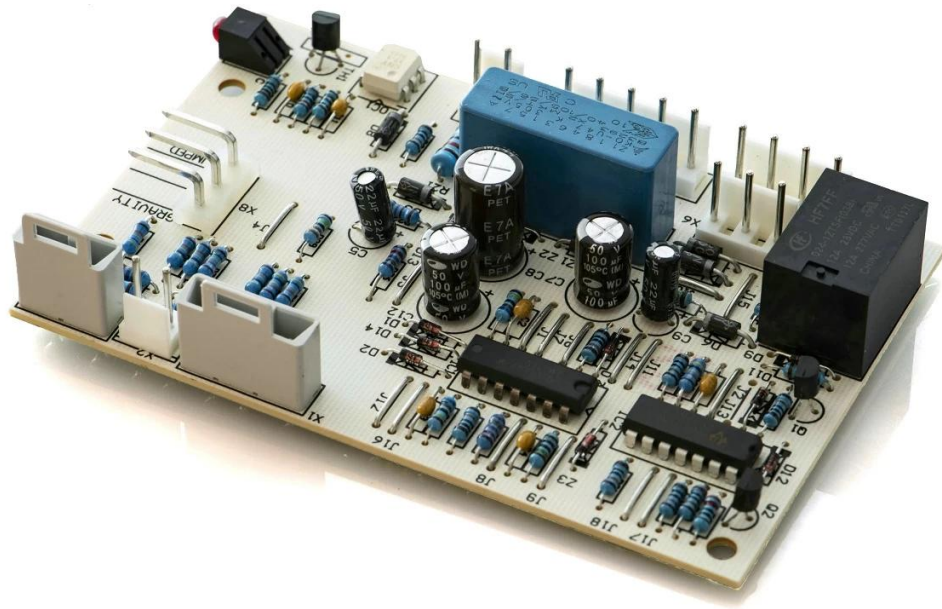
En regardant vers l'avenir, O-leader se concentrera sur l'innovation et le développement de la technologie de fabrication électronique comme toujours, et déploiera des efforts persistants sur le service unique PCB & PCBA pour fournir des services de première classe et créer plus de valeur pour nos clients.

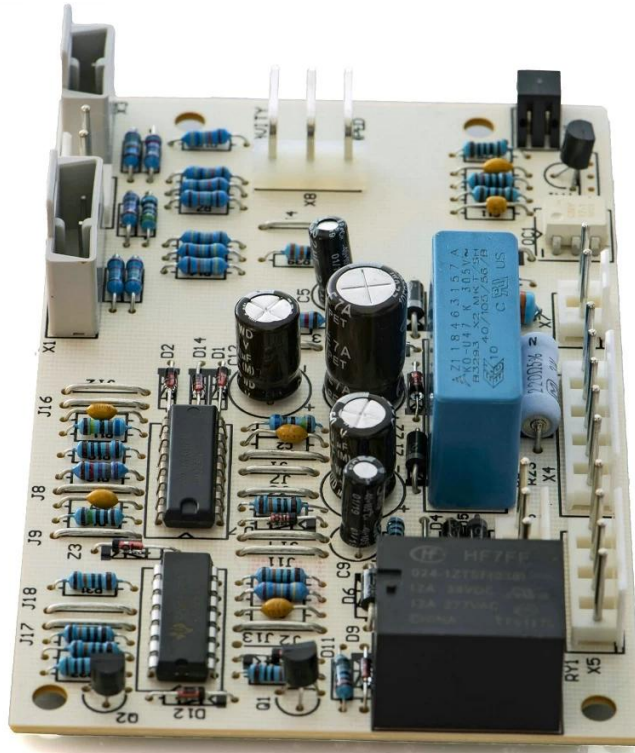
VEUILLEZ CLIQUER ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS: [PCB Assembly manufacturer china](#)

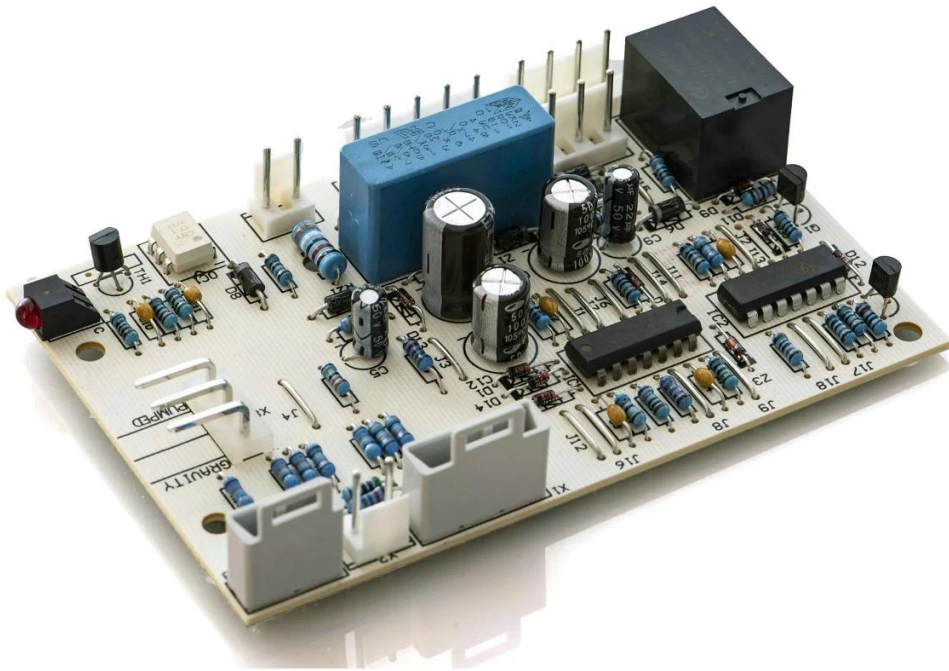
Description du produit

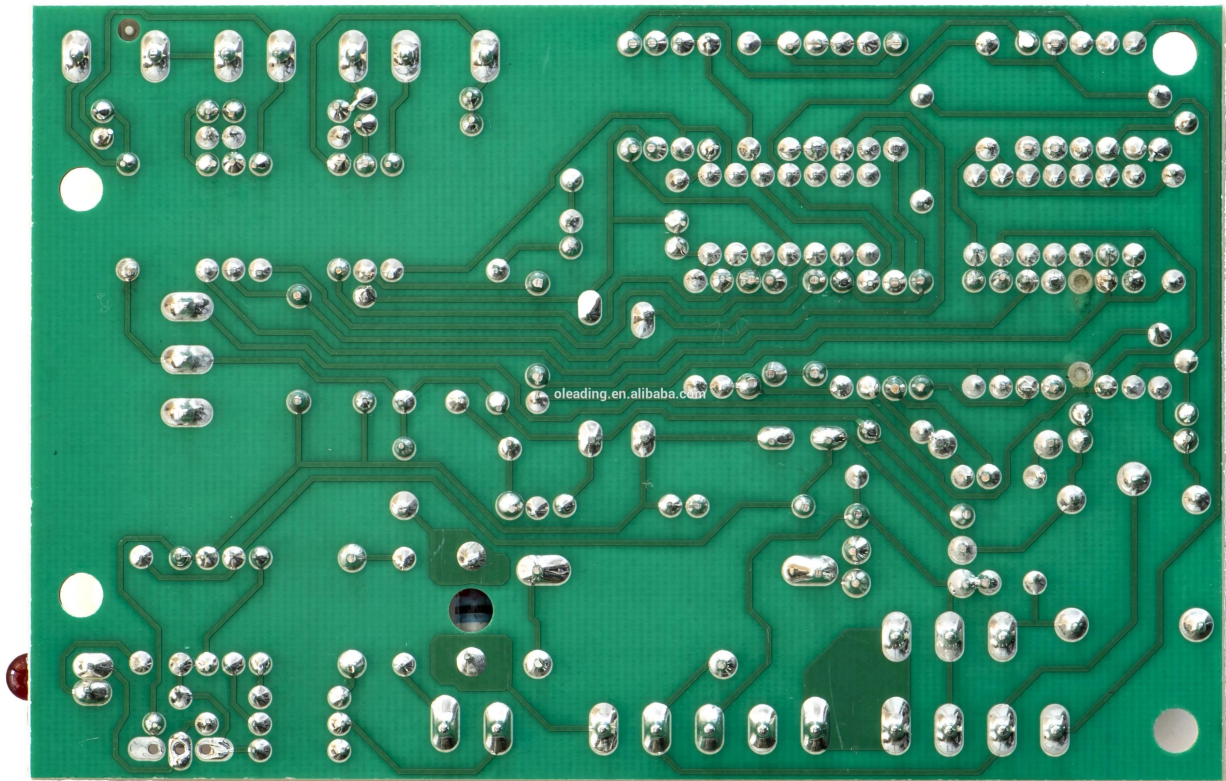












[Assemblage PCB complet clé en main](#)

Notre équipe



Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT



Certifications

CICC INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No: 18118Q10347R05

We hereby certify that

O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED

Credit No: 61691591-000-07-18-7

Registration Add: FLAT/RM 1205 12/F TAI SANG BANK BUILDING 130-132 DES VODEUS ROAD CENTRAL HK

Business Add: 1213, Floor 13, Fortune Building, Danshui Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Has implemented and maintains a **Quality Management System** Which fulfills the requirements of the following standards
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Scope of certification
Sales of printed circuit boards

Initial issuance period: February 27, 2018
Renewal date: April 22, 2019
This certificate is valid during: April 22, 2019 – February 26, 2021
This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period

First supervision and audit	Second supervision and audit	Qualified mark
-----------------------------	------------------------------	----------------

The certification registration number does not include those production stages which fail to be covered by the relevant effective administrative procedures and qualification procedures stipulated by the state. The effectiveness of this certificate shall be restricted to those activities which are covered by the certification. The actual information of this certification can be searched on the internet of CICC www.cicc.com.cn by the site of internet www.cicc.com.cn.






CICC INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

质量管理体系认证证书

证书号: 18118Q10347R05

兹证明

诚领供应链(香港)有限公司

统一社会信用代码: 61691591-000-07-18-7

注册地址: 香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室

经营地址: 广东惠州惠阳淡水南亨西路财富大厦13楼1313

建立的质量管理体系符合
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质量标准适用条款的要求

认证范围
印刷线路板的销售

初次获证日期: 2018年02月27日
换证日期: 2019年04月22日
证书有效期: 自2019年04月22日至2021年02月26日
在下列期限内, 未经CICC黏贴合格标贴, 本证书无效

第一次获证	第二次重审	黏贴处
-------	-------	-----

本证书认证范围不包括未取得有效的国家规定的行政许可、资质许可的产品/服务范围; 本证书通过CICC定期监督审核保持, 与年度《保持认证通知书》共同方为有效; 本证书信息可在国家认监委网站: www.cnca.gov.cn及CICC网站www.cicc.com.cn查询。








Test Report

No. SZXEC1900530401 Date: 30 Mar 2019 Page 1 of 6

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO., LIMITED

1313.FLOOR 13, FORTUNE BUILDING, DANSHUI TOWN, HUIYANG DISTRICT, HUIZHOU, GUANGDONG, CHINA

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the clients as : OSP

SGS Job No. : RP19-005089 - SZ
Date of Sample Received : 22 Mar 2019
Testing Period : 22 Mar 2019 - 30 Mar 2019
Test Requested : Selected test(s) as requested by client.
Test Method : Please refer to next page(s).
Test Results : Please refer to next page(s).

Conclusion : Based on the performed tests on submitted sample(s), the results of Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls (PBBs), Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and Phthalates such as Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), and Diisobutyl phthalate (DIBP) comply with the limits as set by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch

Tina
Tina Fan
Approved Signatory



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com/terms-and-conditions.aspx and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at http://www.sgs.com/terms-and-conditions/Electronic-Documents.aspx. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that unless he/she expressly agrees to the Company's liability at the time of its intended use, the limits of the Company's liability, indemnification and jurisdiction are limited to the extent of the Company's liability, indemnification and jurisdiction under the transaction documents. This document cannot be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this report refer only to the samples tested.

Member of the SGS Group (SGS SA)



Test Report

No. SZXEC1900530401 Date: 30 Mar 2019 Page 2 of 6

Test Results :

Test Part Description :

Specimen No. SGS Sample ID Description
SN1 SZX19-005304.001 Green"PCB"

Remarks :

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
(2) MDL = Method Detection Limit
(3) ND = Not Detected (< MDL)
(4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method : With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Table with 5 columns: Test Item(s), Limit, Unit, MDL, and 027. Lists various substances like Cadmium, Lead, Mercury, Hexavalent Chromium, and various brominated biphenyls with their respective limits and units.



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com/terms-and-conditions.aspx and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at http://www.sgs.com/terms-and-conditions/Electronic-Documents.aspx. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that unless he/she expressly agrees to the Company's liability at the time of its intended use, the limits of the Company's liability, indemnification and jurisdiction are limited to the extent of the Company's liability, indemnification and jurisdiction under the transaction documents. This document cannot be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this report refer only to the samples tested.

Member of the SGS Group (SGS SA)



ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG

Type	Cond Width		Cond Thk mic(mil)	SS/ DS/ DSO	Max	Max		Meets	C	I	
	Min	Edge			Area	Solder	Oper				Flame
	mm(in)	mm(in)			Diam mm(in)	Limits C	Temp sec	Class C	UL796 DSR	T	
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.											
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-
Multilayer printed wiring boards.											
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*
Single layer printed wiring boards.											
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲	*
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL跟踪检验服务的要求。只有带有UL标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.经 UL 允许从在线认证目录转载“声明必须出现在所摘取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

Capacité du processus

Capacités de production de PCB		Capacités de production SMT	
Nombre de couches	1Layer-32Layer	Matériel PCB	FR-4, CEM-1, CEM-3, carte à base d'aluminium
Épaisseur de cuivre fini	1 / 3oz-12oz		
Largeur / espacement des lignes internes	3.0mil / 3.0mil	Taille maximale du PCB	510x460mm
Largeur / espacement des lignes min. Externe	4,0 mil / 4,0 mil	Taille minimale du PCB	50x50mm
Rapport d'aspect max	10: 1	Épaisseur de PCB	0,5 mm à 4,5 mm
Épaisseur du panneau	0,2 mm à 5,0 mm	Épaisseur du panneau	0,5-4 mm
Taille maximale du panneau (pouces)	635 * 1500 mm	Taille minimale des composants	0201
Taille minimale du trou percé	4mil	Composant de taille de puce standard	0603 et plus
Tolérance de trou Plated	+/- 3mil	Hauteur max des composants	15 mm
Blind / Buried Vias (types All)	OUI	Pas de plomb min	0,3 mm
Via Fill (conducteur, non conducteur)	OUI	Terrain de balle BGA min	0,4 mm
Matériel de base	FR-4, FR-4High Tg, Halogen free material, Rogers, Base en aluminium, Polyimide, cuivre lourd	Précision de placement	+/- 0,03 mm
Finitions de surface	HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, Immersion argent, Étain d'immersion, doigts d'or, encre de carbone		

Emballage et livraison

Shipping service



Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

FAQ

1. Comment O-Leading garantit-il la qualité?

Notre norme de qualité élevée est atteinte avec les éléments suivants.

- 1.1 Le processus est strictement contrôlé selon les normes ISO 9001: 2008.
- 1.2 Utilisation extensive de logiciels dans la gestion du processus de production
- 1.3 Équipements et outils de test de pointe. Par exemple. Flying Probe, X-ray Inspection, AOI (Automated Optical Inspector) and ICT (in-circuit testing).
- 1.4 Équipe d'assurance qualité dédiée avec processus d'analyse des cas de défaillance
- 1.5 Formation et éducation continues du personnel

2. Comment O-Leading maintient-il votre prix compétitif?

Au cours de la dernière décennie, les prix de nombreuses matières premières (par exemple le cuivre, les produits chimiques) ont doublé, triplé ou quadruplé; Le RMB de la monnaie chinoise s'est apprécié de 31% par rapport au dollar américain; Et notre coût de main-d'œuvre a également augmenté de manière significative.

Cependant, O-Leading a maintenu nos prix stables. Cela est entièrement dû à nos innovations pour réduire les coûts, éviter les gaspillages et améliorer l'efficacité. Nos prix sont très compétitifs dans l'industrie au même niveau de qualité.

Nous croyons en un partenariat gagnant-gagnant avec nos clients. Notre partenariat sera mutuellement

bénéfique si nous pouvons vous fournir un coût et une qualité de pointe.

3. Quels types de tableaux peuvent être dirigés par O-Leading?

Cartes FR4, TG élevées et sans halogène communes, Rogers, Arlon, Telfon, cartes à base d'aluminium / cuivre, PI, etc.

4. Quelles données sont nécessaires pour la production de PCB et PCBA?

4.1 Nomenclature avec nomenclatures de référence: description des composants, nom du fabricant et numéro de pièce.

4.2 Fichiers PCB Gerber.

4.3 Dessin de fabrication PCB et dessin d'assemblage PCBA.

4.4 Procédures d'essai.

4.5 Toutes restrictions mécaniques telles que les exigences de hauteur d'assemblage.

5. Quel est le flux de processus typique pour les PCB multicouches?

Découpe de matériau → Film sec intérieur → gravure intérieure → AOI intérieur → Multi-bond → Empilement de couches Pressage → Perçage → PTH → Placage de panneau → Film sec extérieur → Placage de motifs → Gravure extérieure → AOI extérieur → Masque de soudure → Marque de composant → Finition de surface → Acheminement → E / T → Inspection visuelle.

6. Quels sont les principaux équipements pour la fabrication HDI?

La liste des principaux équipements est la suivante: perceuse laser, presseuse, ligne VCP, machine d'exposition automatique, LDI, etc.

Les équipements que nous avons sont les meilleurs de l'industrie, les perceuses laser sont de Mitsubishi et Hitachi, les machines LDI sont de Screen (Japon), les machines d'exposition automatique sont également de Hitachi, toutes nous permettent de répondre aux exigences techniques du client.

7. Combien de types de plomb O de finition de surface peuvent faire?

O-the leader a la série complète de finitions de surface, telles que: ENIG, OSP, LF-HASL, placage à l'or (doux / dur), argent à immersion, étain, placage à l'argent, placage à l'étain à immersion, encre au carbone et etc. OSP, ENIG, OSP + ENIG couramment utilisés sur le HDI, nous vous recommandons généralement d'utiliser un client ou OSP OSP + ENIG si la taille du BGA PAD est inférieure à 0,3 mm.

8. Quelle est votre capacité pour FPC? O-Leading peut-il également fournir un service SMT?

O-Leading peut fabriquer du FPC d'une seule couche à 8 couches, la taille du panneau de travail peut être aussi grande que 2000 mm * 240 mm, veuillez trouver les détails dans la page «Capacité Flex»

Nous fournissons également un service unique SMT au client.

9. Quels sont les principaux facteurs qui affecteront le prix des PCB?

Matériel;

Finition de surface;

Difficulté technologique;

Différents critères de qualité;

Caractéristiques des PCB;

Modalités de paiement;

Différents pays de fabrication.

10. Quelle est la définition des PCB, PWB et FPC et quelle est la différence?

PCB est l'abréviation de Circuit imprimé;

PWB est l'abréviation de Printed Wire Board, même sens que Printed Circuit Board;

FPC est l'abréviation de Flexible Printed Board.

11. Quels facteurs devraient être pris en compte lors du choix du matériau pour une carte PCB?

Les facteurs ci-dessous doivent être pris en compte lorsque nous choisissons le matériau pour PCB:
La valeur Tg du matériau doit être supérieure à la température de fonctionnement;
Le matériau à faible CTE a de bonnes performances de stabilité thermique;
Bonnes performances de résistance thermique: Normalement, les PCB doivent résister à 250 °C pendant au moins 50 s.
Bonne planéité; Compte tenu des propriétés électriques, un matériau à faible perte / haute permittivité est utilisé sur les PCB haute fréquence; Substrat en fibre de verre polyimide utilisé pour les PCB flexibles; Le noyau métallique est utilisé lorsque le produit a des exigences strictes de dissipation thermique.

12. Quels sont les avantages du PCB rigid-flex d'O-leader?

Le PCB rigid-flex d'O-leader a les caractères FPC et PCB, il peut donc être utilisé dans certains produits spéciaux. Une partie est flexible tandis que l'autre partie rigide, elle peut aider à économiser l'espace intérieur du produit, à réduire le volume du produit et à améliorer les performances.

13. Comment faites-vous le calcul de l'impédance?

Le système de contrôle d'impédance se fait à l'aide de quelques coupons de test, du SI6000 soft et de l'équipement CITS 500 de POLAR INSTRUMENTS.

L'équipement mesure l'impédance sur un coupon de configuration de voie représentatif dont le client nous a donné une valeur et une tolérance déterminées.